

<<3G终端硬件技术与开发>>

图书基本信息

书名：<<3G终端硬件技术与开发>>

13位ISBN编号：9787115168115

10位ISBN编号：7115168113

出版时间：2008-1

出版时间：人民邮电

作者：李香平

页数：197

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<3G终端硬件技术与开发>>

内容概要

本书介绍了第三代移动终端的发展概况、处理器芯片技术、第三代移动终端的硬件架构与设计（包括射频电路设计、基带电路设计、外围设备的设计）、第三代移动终端中的新技术、第三代移动终端的设计调试方法，是一本有关移动终端硬件技术方面较全面的参考书。

本书结构清晰，内容翔实，适合于通信、电子与IT行业中从事移动通信终端设计、开发、生产、制造、应用及项目管理工作的有关人员阅读。

本书也可供高校通信、电子和计算机等专业的师生参考。

<<3G终端硬件技术与开发>>

书籍目录

第1章 3G移动终端发展概况 1.1 移动通信技术发展简介 1.2 国内外的移动终端市场分析 1.3 移动终端的分类与体系结构 1.4 3G移动终端发展趋势第2章 3G移动终端处理器芯片 2.1 ARM介绍 2.2 ARM处理器系列 2.3 ARM处理器核的分类和扩充标识 2.4 ARM处理器结构介绍 2.5 ARM体系结构的版本和变量 2.6 ARM编程模型 2.7 多核/多处理器技术 参考文献第3章 3G移动终端的硬件架构与设计 3.1 WCDMA移动终端的系统架构与设计 3.2 cdma2000终端的系统架构与设计第4章 3G移动终端的外围设备 4.1 音频和视频设备 4.2 数据连接设备 4.3 智能卡 4.4 内置存储设备 4.5 3G移动终端的存储卡(MMC、CF、SD) 4.6 LCD 4.7 触摸屏 4.8 电池 4.9 3G移动终端键盘 参考文献第5章 3G移动终端中的新技术 5.1 3G终端新技术——接收分集 5.2 3G终端新技术——发射分集 5.3 双/多模手机的发展 5.4 MIMO技术 参考文献第6章 3G终端的设计开发 6.1 通用开发模式和技术概述 6.2 平台开发与调试实例 6.3 BSP的开发与调试技术 6.4 DFT 6.5 DFM常用技术缩略语

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>